

产品描述

EP313(原 3113)底部填充胶是单组分热固化的环氧胶。可快速固化,具有高粘接性能、低模量和可修复性。耐候性佳,贮存稳定性好。可用于针筒点胶。

典型用途

用于倒装芯片中球栅阵列(BGA)和芯片尺寸封装(CSP)等的封装中。

固化前胶液性能

颜色	淡黄色
比重	1.17
粘度 (mPa · s)	 1500-2500
适用期.....	1 周 @25℃
固化时间	4 分钟 @150℃ 15分钟 @120℃
填充速率(10mm填充, 间隙 0.2mm, s)	130

固化后性能(以下性能均在 150℃固化 30 分钟条件测得)

剪切强度(MPa)	16.0
玻璃化温度(℃)	56
热膨胀系数(ppm/℃)	78
硬度(邵氏D)	 70-80
耐溶剂性	 良好
可返修性	 良好
* 标准条件: 温度 23±2℃、相对湿度 50±5%	

使用方法

- 1、 将产品从冰箱取出,室温放置 1~2 小时,使胶液温度达到室温水平。在回温过程中请勿打开包装瓶盖或针筒堵头。针筒包装回温时需保持头向下竖直放置。
- 2、 本胶水可满足手工和自动施胶的要求,在分装或装配的过程中需避免在胶水引入气泡。
- 3、 填充过程中根据工艺要求可在室温下进行或对电路板进行预热。选用合适的针头及气压,沿元器件边缘呈“I”或“L”形施胶,静置等待胶液自动填满元件底部。
- 4、 升温至工艺要求温度,加热固化胶水。

- 5、 未用完的胶水应尽快密封重新保存于冰箱中。不可与未使用的胶水混合保存。
- 6、 返修时先加热器件至焊点融化温度以上,镊子轻夹边角取下器件,用热烙铁小心刮除PCB上残余的胶体和焊锡。使用丙酮或其它合适溶剂清洗表面。

贮存方法和保质期

在阴凉、干燥处贮存, 5℃ (± 3℃)保质期3个月, -10℃ (± 3℃)保质期6个月。

注意事项

详细安全数据参见EP313安全数据表。

声明

本文中所涉及的技术数据均为典型值,不作为产品验收标准,仅供参考。以上数据是在实验室标准条件下取得的,被认为是可靠的。但由于用户使用的工况不同,材料表面状态不同、固化条件不同,实际性能数据有一些变化属正常现象。贮存条件、运输等因素都会使胶的稳定性及物理、机械性能产生影响。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果,海斯迪克公司不承担责任。建议用户在正式使用前,应根据本文提供的数据进行实验。

技术咨询电话: +86-10-68865588。